

# 半導体・パッケージの専門メーカー

## 小さな一滴が世界の最先端を支えます



株式会社アンドウ・ディーケイ

<http://andodk.co.jp/>

### 製品・サービス

#### <導電性接着剤>

##### 高熱伝導タイプ銀ペースト

##### 『AG-03HT』

低応力で反りが非常に少なく、  
大型チップのダイボンドにも適する



ナノ銀粉により銀の配合率を高め  
熱伝導率をさらに上げた【新製品】  
高熱伝導ペーストAG-NA-HT

##### 汎用LSI ダイボンド銀入り接着剤

##### 『CHIPBOND AG-03X7』

LEDからLSIまで使用できる、導熱性接着剤

##### スタンピング用ペースト

##### 『AG-03L』スタンピング用ダイボンド銀ペースト

##### 長時間作業用ダイアタッチ銀ペースト

##### 『AG-03LLF』LEDやLSI用導電性ダイアタッチ接着剤

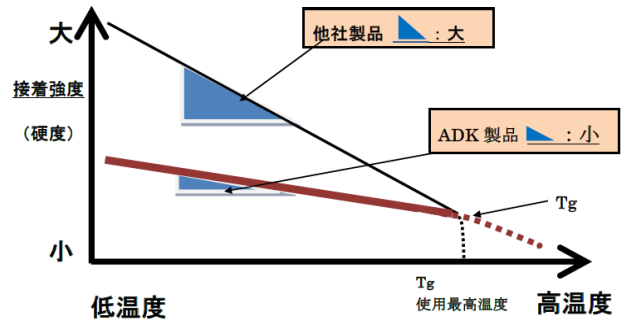


#### <絶縁性接着剤>

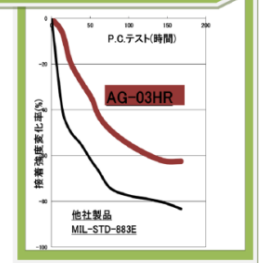
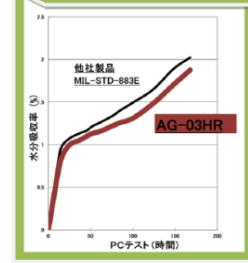
##### ダイボンド用絶縁ペースト 高耐湿 CSP向け

##### 『SI-03LLF』MEMSからLSIまで使用できる絶縁性接着剤

### 製品コンセプト



### プレッシャ-クッカ-テスト



### 経営理念

- 顧客のニーズに対し、常に現実可能な製品特性を提案できる研究開発型企業を目指す
- 耐環境性能にすぐれた信頼性の高い製品を供給する
- 有害性の低い原材料を使用し、人と環境に及ぼす影響を小さくする努力を怠らない

### 代表者メッセージ

安東正昭氏



弊社は、現在、LED、バイポーラIC向け製品が主ですが、用途開発も行い、新商品として有機EL、Si太陽電池への応用、さらに真空シール材を開発し、新たな市場開拓も目指しています。半導体素子用接着剤と、封止材の製造販売を主軸に、顧客からの要望に対応した商品開発を進め、高熱伝導性接着剤の開発、変色しにくいエポキシ接着剤の開発といった新技術開発を進めています。

既存顧客からの、既存製品供給と開発協力の要望に応え、同時に、過去の自らの経験と知識を生かし、市場が要求する半導体素子用接着剤、封止材を新たに開発製造し、半導体製品の利用分野を広げていきたいと考えています。

### 事業概要

弊社は、前身である(株)KIDDの営業譲渡・業務移管を受け、エポキシ樹脂を材料とする高性能接着剤および封止材の製造販売を行い、失われつつある“ものづくりの大切さ”を現代に生かすべく、研究開発企業として平成23年7月に新たに創立いたしました。半導体素子用接着剤および封止材の製造販売を中心として、LED、IC、その他の電子部品向け接着剤および封止材の製造販売を手がけています。①今まで獲得した顧客からの信頼とそれを支える技術、ノウハウを有すること、②エポキシ樹脂の混合と配合に関する豊富な経験と、顧客評価と採用の実績を持つこと、③製品にエポキシ樹脂を主材料に使用することにより、性能のコンセプトが明確であること、④人体への悪影響を極力抑えた製品であること、⑤台湾、中国、ロシア、フランス、アメリカ等多く外国企業との取引経験があり市場要求の国際的変化に対応していく力があることなどを強みとしています。

### 株式会社アンドウ・ディーケイ

住所：神奈川県藤沢市遠藤4489-105 104  
TEL：0466-47-7026 FAX：0466-47-7196  
代表者：安東正昭 設立：2011年7月26日  
資本金：300万円

**ANDO DK CO.,LTD**